

Pressemitteilung

Siltronic AG
Einsteinstraße 172
81677 München
www.siltronic.com

Siltronic beendet Waferfertigung der „kleinen Durchmesser“

München, 22. März 2024 – Die Siltronic AG (MDAX/TecDAX: WAF) plant, die Produktion für polierte und epitaxierte Wafer mit kleinen Durchmessern am Standort in Burghausen schrittweise zu beenden. Die Umsetzung, von der die unpolierten Wafer ausgenommen sind, soll im Laufe des Jahres 2025 abgeschlossen werden.

Aktuell produziert die Siltronic Wafertypen mit einem Durchmesser von 300 mm, 200 mm und kleinere Wafer (Small Diameters, kurz: SD) mit einem Durchmesser von bis zu 150 mm. Die Technologie für die SD-Wafer wurde hauptsächlich in den 90er Jahren und früher entwickelt. Die bedeutendsten technologischen Durchbrüche der letzten Jahrzehnte fanden fortan bei größeren Durchmessern statt, die auch das größte Wachstumspotenzial versprechen. So wird bei 300 mm-Wafern im Schnitt mit einem Volumenwachstum von durchschnittlich 6 Prozent pro Jahr gerechnet.

„Die SD-Wafer-Produktion bei Siltronic hatte ihren Ursprung im Jahr 1968 in Burghausen und hat über viele Jahre zu unserem Erfolg beigetragen, dank der herausragenden Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jedoch hat sich die Waferindustrie aufgrund struktureller Veränderungen und Innovationssprüngen stark gewandelt. Der Bedarf hat sich zunehmend auf Wafer mit größeren Durchmessern und verbesserten Eigenschaften verlagert, während SD-Wafer sich dem Ende ihres Lebenszyklus nähern. Dies führte zu spürbar rückläufigen Volumen, was zuletzt das Ergebnis negativ belastete. Da sich dies in den kommenden Jahren noch verstärken dürfte, haben wir gemeinsam mit dem Aufsichtsrat beschlossen, die Produktion der kleinen Durchmesser schrittweise zu reduzieren und im Laufe des Jahres 2025 einzustellen“, kommentiert Dr. Michael Heckmeier, CEO der Siltronic AG.

„Trotz dieser Entscheidung bleibt der Standort Burghausen für Siltronic von entscheidender Bedeutung. Hier befinden sich unser weltweites Technologie- sowie Forschungs- und Entwicklungszentrum, die Produktion von 300 mm-Wafern und 200 mm-Reinstsiliziumstäben sowie ein großer Teil unserer administrativen Funktionen“, so Michael Heckmeier weiter.

Noch vor 25 Jahren bestand der Silizium-Wafermarkt zu mehr als der Hälfte aus Wafern mit einem Durchmesser bis zu 150 mm, heute sind dies weniger als fünf Prozent, bezogen auf die veröffentlichten Zahlen der Industrieorganisation SEMI. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Kunden aufgrund der dynamischen technologischen Weiterentwicklungen in der Halbleiterindustrie ihre Produktion auf den kleinen Wafern zum Teil reduzieren oder einstellen. Zudem ist der Wettbewerb, vor allem aus China, bei den kleinen Durchmessern inzwischen deutlich spürbar.

Sozialverträgliche Lösungen für die Stammebelegschaft

Im vergangenen Geschäftsjahr verzeichnete der Wafertyp SD am Konzernumsatz einen Anteil im einstelligen Prozentbereich. Der Ergebnisbeitrag war in den letzten Monaten bereits deutlich negativ. Circa 400 Mitarbeitende sind bei den kleinen Durchmessern beschäftigt, davon rund die Hälfte im Rahmen von befristeten und Zeitarbeitsverträgen. Ziel ist, die Stammebelegschaft sozialverträglich über Demographie und Altersteilzeit abzubauen und keine betriebsbedingten Kündigungen auszusprechen.

„Aufgrund der strukturellen Änderungen im Markt gehen wir davon aus, dass es keine Erholung bei SD-Wafern geben wird und der Ergebnisbeitrag der nächsten Jahre deutlich negativ sein würde. Daher haben wir uns zu diesem schwierigen, aber auch notwendigen Schritt entschlossen. Dabei ist es für uns ein wichtiges Ziel, den Personalabbau bei Siltronic sozialverträglich zu gestalten und keine betriebsbedingten Kündigungen auszusprechen. Nach Beendigung der SD-Waferproduktion und den danach gegebenenfalls erforderlichen Rückbaumaßnahmen wird sich unsere EBITDA-Marge mittelfristig um etwa ein bis zwei Prozentpunkte verbessern“, ergänzt Claudia Schmitt, CFO der Siltronic AG.

**Kontakt:**

Verena Stütze
Leiterin Investor Relations & Communications
Tel.: +49 (0)89 8564 3133
E-Mail: investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil:

Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik – von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.500 Mitarbeitende weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten.